

证书号第602305号



发明专利证书

发明名称：具金属块形电接触端子电路组件的平片型封装产品及其制作方法

发明人：陈文隆；胡志良；陈炳南；梁明忠

专利号：ZL 2004 1 0038336.3

专利申请日：2004年5月19日

专利权人：典琦科技股份有限公司

授权公告日：2010年3月3日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月19日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普

